

DHK Company

Introduction



Contents



- 디에이치케이솔루션 소개 (YC 그룹 소개)
- 디스코 및 디스코 기술 소개
- Recruiting

YIKES



Group Introduction



- 반도체 테스트공정에 관한 소재·부품·장비가 핵심 사업 분야
- 반도체 생산 단계별 다양한 역할을 하는 계열회사를 통해 사업적 시너지 극대화

YC EXICON



Semiconductor
Test Equipment

SEMCNS



Fine Ceramic
/ Material

DHK SEMTEK



Saw/grinding
Mechanical Engineering

ORACOM



SMT &
Automation

SEMTOOLS



Industrial Tool

Semiconductor

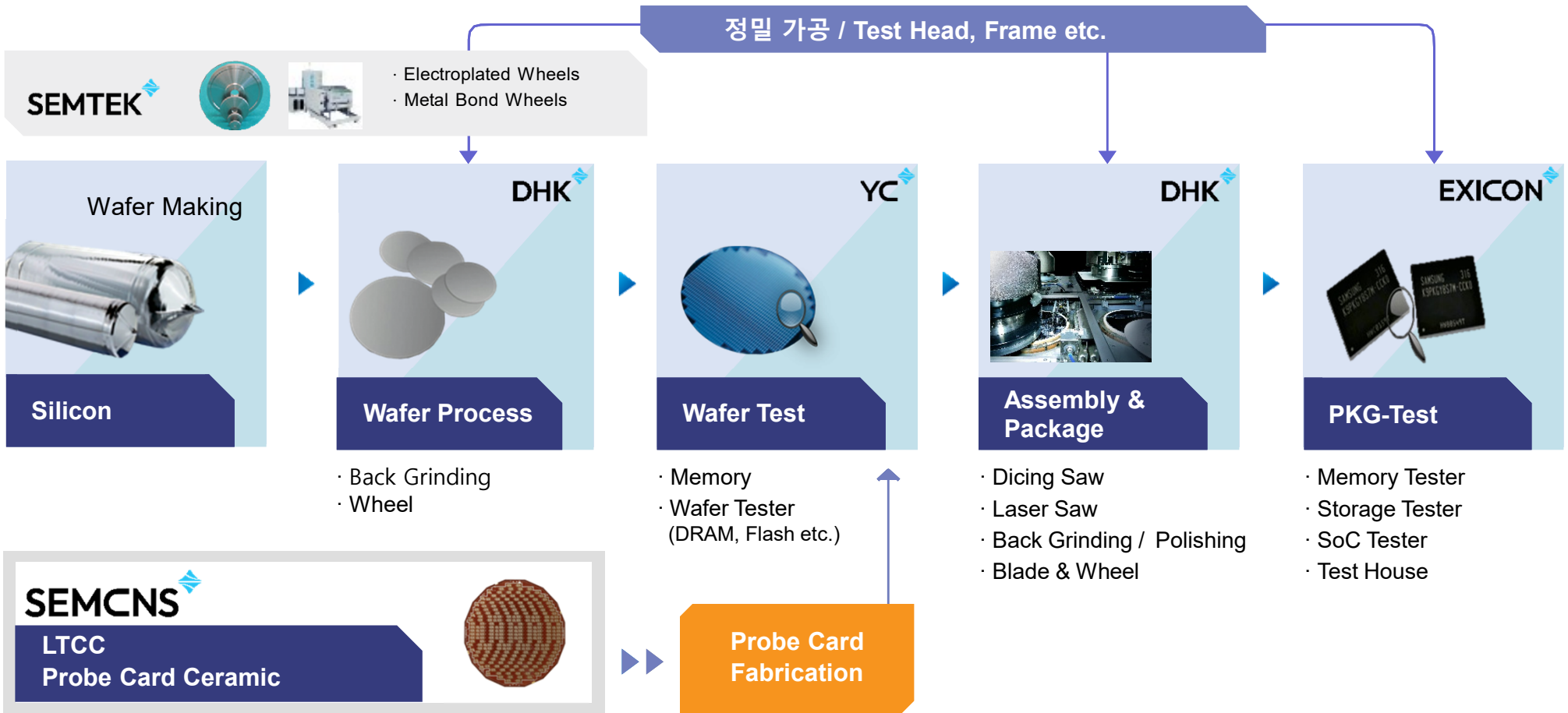
DAS株式会社

Diamond Tool



Business Synergy

- 반도체 생산 단계별로 다양한 역할을 하는 관계사를 가지고 있으며 산업 영향력과 상호 보완을 통해 사업적 시너지가 발생할 수 있도록 조율 및 확장



YC Company Profile



기본 정보

• 최고수준의 양산용 반도체 테스트 장비 개발 및 제공

기업명	(주)와이씨 (YC Corp.)		
소재지	본사: 경기도 성남시 분당구 판교테크노밸리		
주요사업	반도체 웨이퍼테스터 제조		
설립일자	2012년 8월	상장	코스닥 (2017)
임직원	206명	매출액	3,515억

국내외 사업장 현황



연혁

2012 2013 2015 2017 2019 2020 2021 2023 2024 2025



EXICON Company Profile



기본 정보

- 반도체 테스터 제조 업력 20년 이상의 테스터 국산화 선도기업

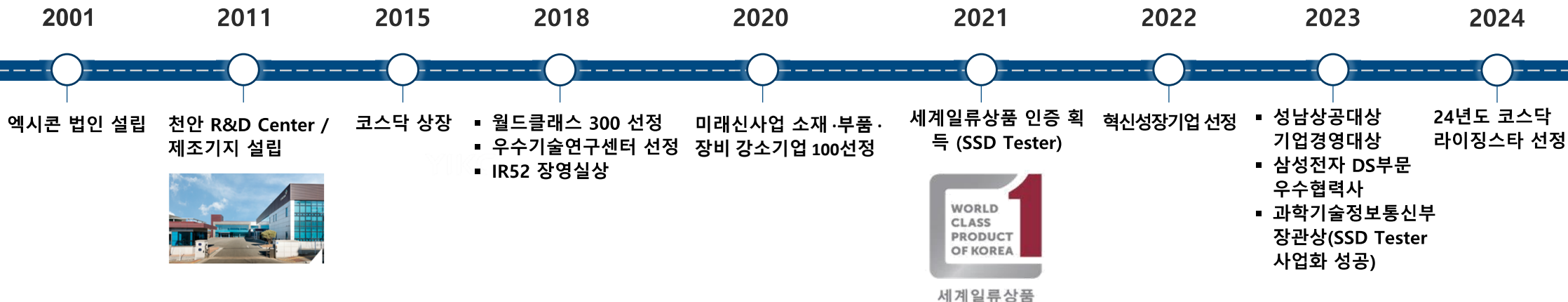
기업명	(주)엑시콘 (EXICON Co. Ltd)		
소재지	본사: 경기도 성남시 분당구 판교테크노밸리		
주요사업	반도체 패키지테스터 제조		
설립일자	2001년 3월	상장	코스닥 (2015)
임직원	179명	매출액	1,253억

국내 사업장 현황

- R&D센터 운영을 통한 기술혁신 기반 구축
- 반도체 분야 산학협업이 유리한 충남 지역 연구소·공장 운영



연혁



세계일류상품

SEMCNS Company Profile



기본 정보

- 세계 최초 無수축 LTCC 세라믹 STF(Space TransFormer) 상용화 기업

기업명	(주) 샘씨엔에스 (SEMCNS Co. Ltd.)		
소재지	본사: 경기도 성남시 분당구 판교테크노밸리		
주요사업	반도체 웨이퍼 테스트 공정용 세라믹 STF		
설립일자	2016년 6월	상장	코스닥 (2021)
임직원	323명	매출액	1,115억

국내 사업장 현황

- 2024년 오송 신축 사옥 설립 및 이전 완료



본사(판교)



신축 사옥 (오송)

연혁

2016

SEMCNS 법인 설립
(삼성전기 STF사업부 인수)



2018

우수기술 연구센터 선정

2019

- 소재부품 전문기업인증
- 뿌리기술 전문기업인증
- 세계일류상품 인증 획득



세계일류상품

2020

- 1천만불 수출의 탑 수상
- 중소기업 기술개발 혁신사업 선정

2021

코스닥 상장



2022

- 혁신성장기업 선정
- 중견기업 성장
- 청주시와 오송공장 700억 투자 협약
- 코스닥라이징스타 선정 (22, 23, 25년)

2025

혁신프리미어 1000 선정

2026

반도체 핵심 소부장 기업 지원 대상 선정

DHK Company Profile



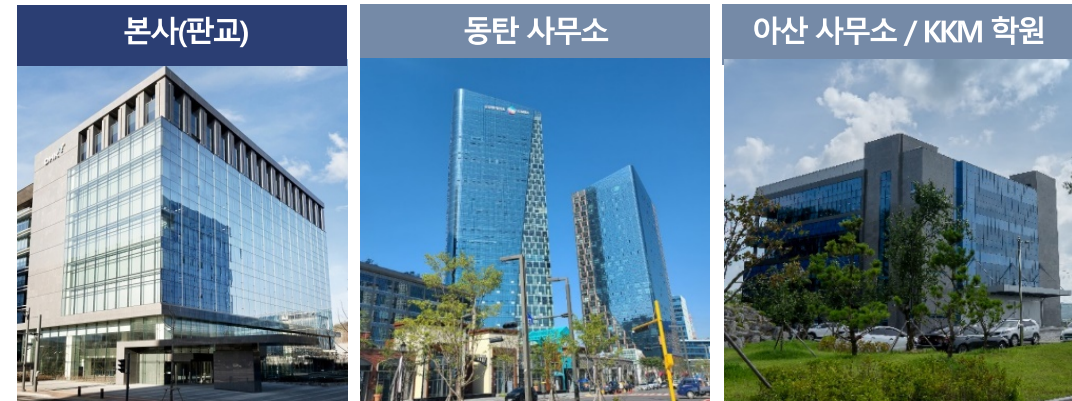
기본 정보

- 반도체 Grinding, Sawing 장비의 Total Solution 제공

기업명	디에이치케이솔루션 (주) (DHK Solution Corporation)		
소재지	본사: 경기도 성남시 분당구 판교테크노밸리		
주요사업	반도체 장비 판매 및 Maintenance 서비스		
설립일자	2006년 7월	상장	-
임직원	147명	매출액	334억

국내 사업장 현황

- 고객 대응력 강화를 위한 동탄, 아산 엔지니어 거점 마련



연혁

2006 2011 2013 2018 2021 2022 2025



DHK Business Overview



日 DISCO사의 장비와 소모품 판매 및 기술지원

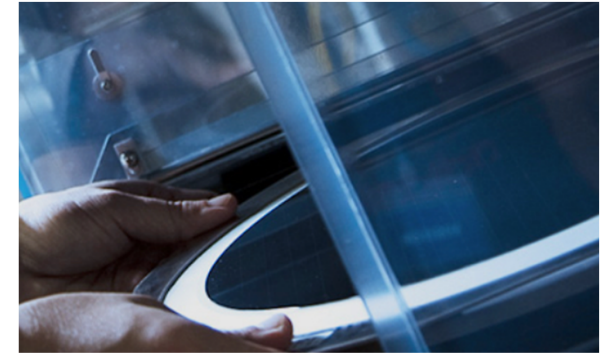
DISCO 장비판매



장비 소모품 판매



기술지원·유지보수



“ 반도체 공정 장비 중 Grinding, Sawing 장비 세계 시장 점유율 70% 이상을 차지하는
日 DISCO사의 장비를 반도체 회사 고객에게 독점 공급하고 있는 Total Solution Provider ”

DHK Training Center (Asan)



- 높은 지식과 경험이 있는 트레이너들이 고객 및 신입사원들에 대한 전문적인 트레이닝을 통해 즉시 현장에서 활약 할 수 있는 엔지니어가 될 수 있도록 지원



기본 트레이닝

Dicer 교육

Laser 교육

Grinder 교육

“ 엔지니어 양성 ”

“Always the best, Always fun”

DISCO Company Profile



Kiru · Kezuru · Migaku Technologies



※ World Wide

62 sites

지점 / 대리점

7,349

임직원 수

연혁

1937

Dai-Ichi Seitoshō Co. Ltd. 설립

1969

미국 현지법인 설립

1977

상호변경
(주식회사 DISCO)



1999

도쿄 증권거래소 제1부에 상장

2004

본사/R&D센터 도쿄 신축 이전



2006

대한민국 내 합자법인 설립 (DHK솔루션)



2019

쿠와바타공장 A동 C존 준공



2022

하네다 R&D센터 개설, 연구개발 기능 증강

2024

인도 현지법인 설립

DISCO's Technology

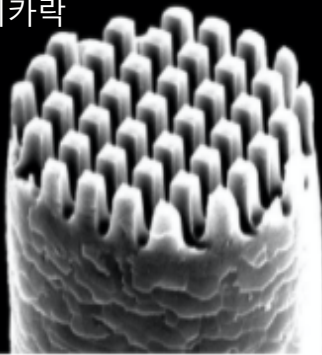


Dicing

Smaller more Precise



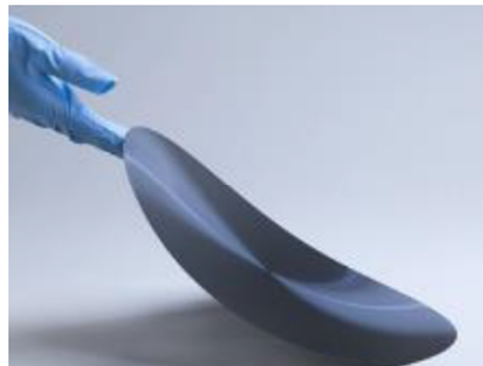
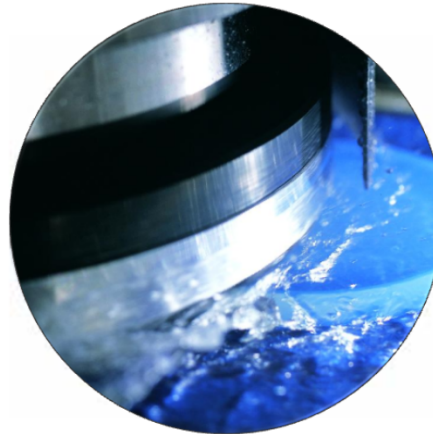
* 머리카락
단면



작게 잘라 나누는 (Kiru)

Grinding

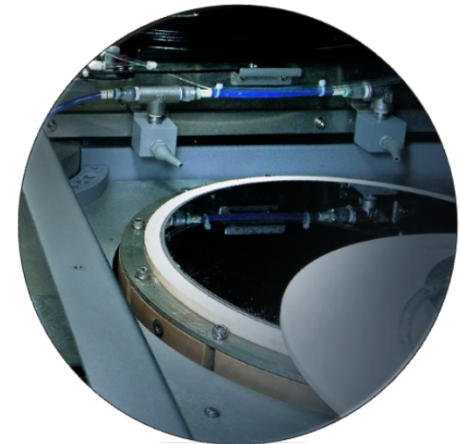
Thinner & Flatter



얇게 갈아내는(Kezuru)

Polishing

Smoother & Stronger



거울처럼 닦아내는(Migaku)



Recruiting

■ 모집내용

모집 분야	지원 요건 및 우대사항	담당 직무	채용인원	근무지
장비 엔지니어	- 전공 무관 (공학계열, 일본어학과 우대)	반도체장비 Set-up, Maintenance	00명	아산 · 동탄
영업	- 전공 무관 - 비즈니스 일본어 가능자	반도체 장비, 부품 영업	0명	판교

■ 지원접수기간 : 5.26 ~ 6.14

서류 접수 ▶ 1차·2차 면접 ▶ 입사(8월중)

- 작성안내 : 당사 홈페이지(www.dhk.co.kr) 지원양식 다운받아 작성

Recruiting



■ 처우 및 복리후생

- 1) 근무시간 : 09:00 ~ 18:00 (주5일 근무)
- 2) 급여수준 : 대졸 신입 기준 기본급 **3,800만원/년**
차량유지비 및 각종 수당, 4회/년 인센티브 지급
- 3) 복리후생



기숙사 지원



구내 식당
운영



어학교육 지원



자녀 입학축하금
(초,중,고,대)



장기근속 포상



경조사 지원



본인/가족
건강검진 지원



휴양시설/리조트
회원가 지원



근무복 지급



기념일
선물



Thank you

